

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 26 年 9 月 11 日 (2014.9.11)

【公開番号】特開 2012-69928 (P2012-69928A)

【公開日】平成 24 年 4 月 5 日 (2012.4.5)

【年通号数】公開・登録公報 2012-014

【出願番号】特願 2011-180658 (P2011-180658)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/56 (2006.01)

H 0 1 L 23/29 (2006.01)

H 0 1 L 23/31 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/56 E

H 0 1 L 23/30 D

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 7 月 28 日 (2014.7.28)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に、長さ X (X は 5 mm 以下) の端子部と素子部とを形成し、  
前記素子部上に、前記素子部を覆うように段差層を形成し、  
前記段差層上に、前記素子部を覆うように可撓性を有する保護部材を設置し、  
前記保護部材と、張り合わせ部材とを押し当てることで、前記保護部材を前記段差層に  
接着させ、  
前記断層の厚さは、0 . 3 8 X 以上 2 mm 以下であり、  
前記張り合わせ部材は、表面硬度は 5 0 以上 1 0 0 以下の弾性材料であることを特徴と  
する半導体装置の作製方法。

【請求項 2】

基板上に、長さ X (X は 5 mm 以下) の端子部と素子部とを形成し、  
前記素子部上に、前記素子部を覆うように段差層を形成し、  
前記段差層上に、前記素子部を覆うように可撓性を有する保護部材を設置し、  
前記保護部材と、張り合わせ部材とを押し当てることで、前記保護部材を前記段差層に  
溶着させ、  
前記断層の厚さは、0 . 3 8 X 以上 2 mm 以下であり、  
前記張り合わせ部材は、表面硬度は 5 0 以上 1 0 0 以下の弾性材料であることを特徴と  
する半導体装置の作製方法。